

平成30年 5月 8日
一般社団法人 日本電子デバイス産業協会
事務局 小林 関 司

材料部品部会主催の第十九回勉強会のご案内

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

来る6月13日(水曜日)に下記のテーマで材料部品部会主催の第十九回勉強会を実施いたします。

日本の電子デバイス産業を発展させる為には国内外の動向を常に把握し次世代を見据えた電子デバイスの開発が望まれるところです。今回の勉強会では、三人の講師をお招きし国内外の最新の技術動向、電子デバイス産業の今年の大躍進を中心に下記のテーマで勉強会を実施いたします。

今回の勉強会も大変貴重な機会ですので皆様多数のご参加をお待ちしております。

日時 平成29年6月13日(水) 13:00~16:30
場所 御茶ノ水めっきセンター 4F会議室 03-3814-5621 (代)
東京都文京区湯島1-11-10 <http://www.tmk.or.jp/gaiyou.html>

[プログラム]

13:00~14:00

「最先端モルディング技術の紹介」

講師 竹内 慎 氏/TOWA 株式会社 開発本部 装置開発部)

~~WLP/PLPを実現する為のコンプレッション成型技術~~

14:00-15:00

「電子デバイスを支える部品装着技術」

講師 楠 一弘 氏/ 株式会社 FUJI 株式会社ソリューション事業本部 第一機械技術部

技術企画課 シニアリーダー (15:00-15:15 休憩)

15:15-16:30

「自動車世界戦争の始まりで日本の電子デバイスが抜け出す」

~センサー、マイコン、電池、回路基板でトップシェア獲得~

講師 泉谷 渉 氏/(株)産業タイムズ社・代表取締役社長

(注) 参加希望の方は別紙回答用紙にて、**6月6日までに**メールでお申し込みください。

確認後メール返信いたします。

募集予定人員60名(定員を超えましたら、締め切らせていただきます)。

なお当日、配布資料代として NEDIA 会員の方は 2,000 円/人を、また非会員の方は 5,000 円/人(資料代含む)を徴収いたしますのでご承知おきください。

以上